

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

728

ML4

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

27.02.2017



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	----	--------	---------------

Polyimid 50µ -18µ eins CU Kleberlos 460x305...	50201120	<div>18</div> <div>50</div>	VS	<div>1</div> <div></div>	
A-RS-FR4-Prepreg-106-LowFlow-R1551LE	50200912	<div>50</div>		<div>2</div> <div></div>	A01
A-RS-FR4-ML-0.71mm-018+018-TG150-HF	50200793	<div>0</div> <div>710</div> <div>0</div>	L2 L3	<div>3</div> <div></div>	A02 B00
A-RS-FR4-Prepreg-106-TG150-HF	50200640	<div>50</div>		<div>4</div> <div></div>	
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	<div>18</div>	RS	<div>5</div> <div></div>	

Dicke nach Verpressen

B00:

890 µm

 Tol+:

100 µm

 Tol-:

100 µm

 Dmax:

990 µm

 Dmin:

790 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

 Tol+:

0 µm

 Tol-:

0 µm

 Dmax:

0 µm

 Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

1000 µm

 Tol+:

100 µm

 Tol-:

100 µm

 Dmax:

1100 µm

 Dmin:

900 µm

Messstelle:

(05) über LM und galv.Cu; beidseitig

 nominal:

896 µm

Version 1.2.16.24

© Würth Elektronik